

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕138号）。

发行人的股票简称为“矽电股份”，股票代码为“301629”。发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币 52.28 元/股。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行新股 1,043.1819 万股，本次公开发行后公司总股本为 4,172.7274 万股，发行股份占发行后公司总股本的比例约为 25.00%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行网上发行股票数量为 1,043.1500 万股，占本次发行总量的 99.9969%，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 319 股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2025 年 3 月 13 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,374,808
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：542,394,962.24
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：56,692
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,963,857.76

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 56,692 股，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股为 319 股，两者合计为 57,011 股。本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为 57,011 股，包销金额为 2,980,535.08 元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.55%。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 8,184.68 万元，其中：

1、承销及保荐费：4,480.00 万元，保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费：1,825.47 万元，依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费：1,388.80 万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：476.42 万元；

5、发行手续费及其他费用：14.00 万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

发行人： 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司

2025 年 3 月 17 日

（此页无正文，为《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司



2025年3月17日

（此页无正文，为《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2025年3月17日